

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

15. 6. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

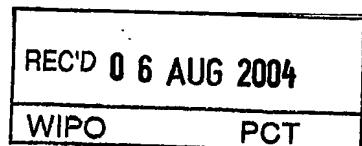
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2003年 6月30日
Date of Application:

出願番号 特願2003-188468
Application Number:

[ST. 10/C] : [JP2003-188468]

出願人 TDK株式会社
Applicant(s):



PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 7月23日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川

洋

【書類名】 特許願
【整理番号】 TD0153
【提出日】 平成15年 6月30日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 C23F 4/00
H01L 21/3065

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社
内

【氏名】 大川 秀一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社
内

【氏名】 服部 一博

【特許出願人】

【識別番号】 000003067

【氏名又は名称】 TDK株式会社

【代理人】

【識別番号】 100076129

【弁理士】

【氏名又は名称】 松山 圭佑

【選任した代理人】

【識別番号】 100080458

【弁理士】

【氏名又は名称】 高矢 諭

【選任した代理人】

【識別番号】 100089015

【弁理士】

【氏名又は名称】 牧野 剛博

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006622

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【その他】 平成15年6月27日付で名称変更届を提出しております。

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 反応性イオンエッティング用のマスク材料、マスク及びドライエッティング方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

含窒素化合物ガスが添加された一酸化炭素ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティング用のマスク材料であって、

ケイ素と、タンタルと、を含むことを特徴とする反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【請求項 2】

請求項 1において、

ケイ素とタンタルとの化合物、ケイ素とタンタルとの混合物のいずれかを含むことを特徴とする反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【請求項 3】

請求項 1又は 2において、

ケイ素を含む材料を層状に形成してなるケイ素系材料層と、タンタルを含む材料を層状に形成してなるタンタル系材料層と、を積層してなる積層体であることを特徴とする反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【請求項 4】

請求項 1乃至 3 のいずれかにおいて、

ケイ素とタンタルとを含む酸化物、ケイ素とタンタルとを含む窒化物、ケイ素の酸化物、ケイ素の窒化物、タンタルの酸化物、タンタルの窒化物の少なくとも一の材料を含むことを特徴とする反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【請求項 5】

請求項 1乃至 4 のいずれかにおいて、

ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計してなる原子数に対する前記ケイ素の原子数の比率が 0 % よりも大きく、且つ、 50 % 以下であることを特徴とする反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【請求項 6】

請求項5において、

ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計してなる原子数に対する前記ケイ素の原子数の比率が10%以上、且つ、30%以下であることを特徴とする反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【請求項7】

請求項1乃至6のいずれかに記載の反応性イオンエッティング用のマスク材料で構成されたことを特徴とする反応性イオンエッティング用のマスク。

【請求項8】

請求項1乃至6のいずれかに記載の反応性イオンエッティング用のマスク材料で構成されたマスク層を被加工体上に所定のパターンで形成するマスク形成工程と、含窒素化合物ガスが添加された一酸化炭素ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティングにより前記被加工体を前記パターンの形状に加工する被加工体加工工程と、を含むことを特徴とするドライエッティング方法。

【請求項9】

請求項8において、

前記マスク形成工程は、前記マスク層を第1のマスク層として、該第1のマスク層を前記被加工体上に成膜し、該第1のマスク層上に前記パターンで第2のマスク層を形成し、ハロゲン系ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティングにより前記第1のマスク層を前記パターンの形状に加工する工程であることを特徴とするドライエッティング方法。

【請求項10】

請求項8又は9において、

前記被加工体として、磁性材を加工することを特徴とするドライエッティング方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば磁性材の加工等に用いられる反応性イオンエッティング用のマスク材料、マスク及びドライエッティング方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、磁性材等の微細加工技術として、NH₃（アンモニア）等の含窒素化合物ガスが添加されたCO（一酸化炭素）ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティング（例えば、特許文献1参照）が知られている。尚、この反応性イオンエッティングは、Pt（白金）等の非磁性材の加工にも用いることができる。

【0003】

この反応性イオンエッティングは、磁性材等を構成する遷移金属とCOガスとを反応させて結合エネルギーが小さい遷移金属カーボニル化合物を生成し、生成した遷移金属カーボニル化合物をスパッタリング作用で除去して磁性材等を所望の形状に加工するものである。尚、含窒素化合物ガスはCOがC（炭素）とO（酸素）に分解することを抑制し、遷移金属カーボニル化合物の生成を促進するために添加されている。

【0004】

この反応性イオンエッティング用のマスク材料としては、Ti（チタン）、Mg（マグネシウム）、Al（アルミニウム）等を構成成分とするマスク材料が知られている（例えば、特許文献2参照）。又、本出願と同一の出願人は、磁性材に対してエッティングレートが著しく低く、エッティングの選択性に優れたマスク材料として、Ta（タンタル）を構成成分とするマスク材料を提案している（例えば、特許文献3参照）。尚、これらのマスク材料で構成されるマスクを所望のパターンに加工する技術としては、半導体製造の分野で一般的な、ハロゲン系ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティング等を用いることができる。

【0005】

このようなドライエッティングの手法を用いることにより、磁性材等の種々の微細加工が可能であると考えられている。

【0006】

例えば、ハードディスク等の磁気記録媒体は、磁性薄膜層を構成する磁性粒子の微細化、材料の変更、ヘッド加工の微細化等の改良により面記録密度が著しく向上しているが、これら磁性粒子の微細化等の改良手法は限界にきており、一層

の面記録密度の向上を実現しうる磁気記録媒体の候補として、磁性薄膜層を多数の微細な記録要素に分割してなるディスクリートタイプの磁気記録媒体が提案されている（例えば、特許文献4参照）。このようなディスクリートタイプの磁気記録媒体を実現するためには領域幅が $1 \mu\text{m}$ 以下の微細領域の加工が要求されるが、上述のドライエッチングの手法を用いることにより、このような微細加工も可能であると考えられていた。

【0007】

【特許文献1】

特開平12-322710号公報

【特許文献2】

特開平11-92971号公報

【特許文献3】

特開2001-274144号公報

【特許文献4】

特開平9-97419号公報

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記のようなドライエッチングの手法を用いることで、磁性材等に微細なパターンを形成することはできても、図10（A）に示されるような側面100が垂直な理想的な形状の凹部102を形成することは困難で、実際には図10（B）に示されるような側面104がテーパ形状の凹部106が形成され、所望の加工形状と、実際の加工形状と、の間に、一定のずれが生じていた。より詳細に説明すると、ドライエッチングでは、一部のガスが被加工体に対して垂直方向から若干傾斜して接近し、エッチング対象領域の端部はマスク108から露出していても一部のガスに対してマスク108の陰となるため、他の部分よりもエッチングの進行が遅れ、側面がテーパ形状の凹部が形成されると考えられる。エッチング対象領域の微細化に伴い、このような加工形状のずれが製品の特性等に及ぼす影響が相対的に大きくなる傾向があり、側面のテーパ角を低減する（即ち側面を垂直に近づける）ドライエッチング技術に対するニーズが高まって

いる。

【0009】

又、被加工体のドライエッチングのために、被加工体には一又は複数のマスクが形成され、マスクも一般的にドライエッチングで加工されて側面がテーパ形状の溝が形成されるため、最表面のマスクの凹部は順次狭まりつつ被加工体に転写されることになる。凹部が過度に狭くなると被加工体には両側面が連続したV字断面の凹部が形成されて、エッチングがそれ以上進行しなくなり、所望の深さまで加工できないことがある。例えば、上述のディスクリートタイプの磁気記録媒体では、磁性薄膜層の厚さよりも浅いV溝が形成され、磁性薄膜層を分割できないことがある。

【0010】

尚、凹部側面のテーパ角を考慮し、最表面のマスクに充分大きな幅の凹部を形成すれば、このような事態を回避しうるが、パターンが微細で凹部同士の間隔が小さい場合、最表面で凹部同士が連続し、各凹部を区別して形成できないことがある。

【0011】

更に、マスクにおける凹部側面のテーパ角が大きいと、それだけ被加工体へのパターンの転写精度が低下しやすいという問題がある。

【0012】

本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであって、含窒素化合物ガスが添加された一酸化炭素ガスを反応ガスとする反応性イオンエッチングを用いて被加工体を精密に加工することができるドライエッチング方法等を提供することをその課題とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】

本発明は、含窒素化合物ガスが添加された一酸化炭素ガスを反応ガスとする反応性イオンエッチング用のマスク材料として、ケイ素と、タンタルと、を含む材料を用いることにより、上記課題を解決するに至った。

【0014】

発明者は、本発明に想到する過程において、ドライエッチングのマスク材料として種々の材料を試行錯誤したところ、ケイ素と、タンタルと、で構成されたマスク材料は、ハロゲン系ガスを反応ガスとする反応性イオンエッチングで加工する際、バイアスパワーの値等の設定条件により、加工形状が変化しやすいことを見出した。

【0015】

一例を示すと、反応性イオンエッチングにおけるバイアスパワーを低減すると、マスクに形成される凹部側面のテーパ角が低減した。このようにマスクの凹部側面のテーパ角を低減することで、それだけ凹部同士の間隔が狭い微細なパターンを加工することができる。又、マスクの凹部側面のテーパ角を低減することで、被加工体へのパターンの転写精度を高めることができる。

【0016】

このように反応性イオンエッチングの設定条件により、マスクの加工形状が変化する理由は必ずしも明らかではないが、概ね次のように考えられる。

【0017】

反応性イオンエッチングでは、イオンの衝突という物理的作用と反応ガスの化学的作用との相乗効果により、エッチングが進行する。従来は、ガス圧の低減、バイアスパワーの増加等により、イオンの直進性を高めて凹部側面のテーパ角を抑制していた。即ち、主として反応性イオンエッチングの物理的作用を制御して、凹部側面のテーパ角を抑制していた。しかしながら、このようなガス圧、バイアスパワーの調整によるイオンの直進性の向上は既に限界にきており、被加工物に対して接近する総てのイオンを完全に垂直方向に指向することはできなかった。

【0018】

一方、ケイ素は、タンタルよりもハロゲン系の反応ガスと反応しやすいため、ケイ素と、タンタルと、を含むマスク材料は、タンタル単体よりも、ハロゲン系ガスの化学的作用によるエッチングが進行しやすい。言い換えれば、物理的作用を多少抑制しても、エッチングが充分進行することになる。化学的作用によるエッチングは等方的に進行するため、（該マスクの加工のための他の）マスクの陰

になる部分のエッティングが促進され、側面のテーパ角が小さくなると考えられる。

【0019】

即ち、反応性イオンエッティングの物理的作用を高め、イオンの直進性を向上させることで凹部側面のテーパ角を抑制することが常識とされていた従来の技術に対し、本発明は着想、構成が全く異なっており、反応性イオンエッティングの物理的作用を抑制する一方、化学的作用を高めるという従来の反応性イオンエッティングの技術とは逆の手法で凹部側面のテーパ角が低減されていると考えられる。

【0020】

尚、タンタルを含まないケイ素系材料も、タンタル単体よりも、ハロゲン系の反応ガスと反応しやすくエッティングが進行しやすいが、タンタルを含まないケイ素系材料は一酸化炭素を反応ガスとする反応性イオンエッティングにおいてもエッティングが進行しやすいためマスク材料として不適当である。

【0021】

これに対し、ケイ素と、タンタルと、を含む材料は、一酸化炭素を反応ガスとする反応性イオンエッティングにおいて充分な耐エッティング性を有し、マスク材料として好適である。

【0022】

更に、発明者は、ケイ素と、タンタルと、を含む材料は、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計してなる原子数に対するケイ素の比率を50%以下に制限することにより、一酸化炭素を反応ガスとする反応性イオンエッティングに対する耐エッティング性がタンタル単体よりも大きくなることを見出した。即ち、それだけマスクの厚さを薄くすることができ、これによりマスクの陰になる部分を低減し、被加工体に形成される凹部側面のテーパ角を低減することができる。

【0023】

即ち、次のような本発明により、上記課題の解決ができる。

【0024】

(1) 含窒素化合物ガスが添加された一酸化炭素ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティング用のマスク材料であって、ケイ素と、タンタルと、を含むこと

を特徴とする反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【0025】

(2) ケイ素とタンタルとの化合物、ケイ素とタンタルとの混合物のいずれかを含むことを特徴とする前記(1)の反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【0026】

(3) ケイ素を含む材料を層状に形成してなるケイ素系材料層と、タンタルを含む材料を層状に形成してなるタンタル系材料層と、を積層してなる積層体であることを特徴とする前記(1)又は(2)の反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【0027】

(4) ケイ素とタンタルとを含む酸化物、ケイ素とタンタルとを含む窒化物、ケイ素の酸化物、ケイ素の窒化物、タンタルの酸化物、タンタルの窒化物の少なくとも一の材料を含むことを特徴とする前記(1)乃至(3)のいずれかの反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【0028】

(5) ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計してなる原子数に対する前記ケイ素の原子数の比率が0%よりも大きく、且つ、50%以下であることを特徴とする前記(1)乃至(4)のいずれかの反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【0029】

(6) ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計してなる原子数に対する前記ケイ素の原子数の比率が10%以上、且つ、30%以下であることを特徴とする前記(5)の反応性イオンエッティング用のマスク材料。

【0030】

(7) 前記(1)乃至(6)のいずれかに記載の反応性イオンエッティング用のマスク材料で構成されたことを特徴とする反応性イオンエッティング用のマスク。

【0031】

(8) 前記(1)乃至(6)のいずれかに記載の反応性イオンエッティング用のマスク材料で構成されたマスク層を被加工体上に所定のパターンで形成するマス

ク形成工程と、含窒素化合物ガスが添加された一酸化炭素ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティングにより前記被加工体を前記パターンの形状に加工する被加工体加工工程と、を含むことを特徴とするドライエッティング方法。

【0032】

(9) 前記マスク形成工程は、前記マスク層を第1のマスク層として、該第1のマスク層を前記被加工体上に成膜し、該第1のマスク層上に前記パターンで第2のマスク層を形成し、ハロゲン系ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティングにより前記第1のマスク層を前記パターンの形状に加工する工程であることを特徴とする前記(8)のドライエッティング方法。

【0033】

(10) 前記被加工体として、磁性材を加工することを特徴とする前記(8)又は(9)のドライエッティング方法。

【0034】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して詳細に説明する。

【0035】

本実施形態は、図1に示される試料の出発体にドライエッティング等の加工を施すことにより、図2に示されるような所定のラインアンドスペースパターンの形状に磁性薄膜層(磁性材)を加工するものであり、磁性薄膜層を被覆するマスクの材料、マスクの加工工程に特徴を有している。他の構成については従来と同様であるので説明を適宜省略することとする。

【0036】

試料10の出発体は、ガラス基板12に、磁性薄膜層16、第1のマスク層18、第2のマスク層20、レジスト層22がこの順で形成された構成である。

【0037】

磁性薄膜層16は、厚さが5～30nmで、材料はCoCr(コバルト-クロム)合金である。

【0038】

第1のマスク層18は、厚さが5～50nmで、材料はケイ素と、タンタルと

、を混合したものである。又、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率は（10%以上、且つ、30%以下の）約20%である。

【0039】

第2のマスク層20は、厚さが5～30nmで、材料はNi（ニッケル）である。

【0040】

レジスト層22は、厚さが30～300nmで、材料は電子線レジスト（ZEP520　日本ゼオン社）である。

【0041】

試料10の加工は、図3に示されるような反応性イオンエッチング装置等を用いて行う。

【0042】

反応性イオンエッチング装置30はヘリコン波プラズマ方式であり、拡散チャンバー32と、拡散チャンバー32内に試料10を載置するためのESC（静電チャック）ステージ電極34と、プラズマを発生するための石英製ベル・ジャー36と、を備えている。

【0043】

ESCステージ電極34にはバイアス電圧を印加するためのバイアス電源38が結線されている。尚、バイアス電源は、周波数が1.6MHzの交流電源である。

【0044】

石英製ベル・ジャー36は下端が拡散チャンバー32内に開口し、半球面上の上部中央近傍には反応ガスを給気するための給気孔36Aが設けられている。又、石英製ベル・ジャー36の周囲には、電磁コイル40と、アンテナ42が配設され、アンテナ42にはプラズマ発生電源44が結線されている。尚、プラズマ発生電源44は、周波数が13.56MHzの交流電源である。

【0045】

次に、試料10の加工方法について、図4に示すフローチャートに沿って説明

する。

【0046】

まず、図1に示される試料10の出発体を用意する（S102）。試料10の出発体はガラス基板12に、磁性薄膜層16、第1のマスク層18、第2のマスク層20を、この順でスパッタリング法により形成し、更にレジスト層22をスピニコート法で塗布することにより得られる。

【0047】

この試料10の出発体のレジスト層22に電子線露光装置（図示省略）を用いて露光し、ZED-N50（日本ゼオン社）を用いて室温で5分現像して露光部を除去し、図5に示されるように微細な間隔で多数の溝を形成する（S104）。

【0048】

次に、Ar（アルゴン）ガスを用いたイオンビームエッチング装置（図示省略）を用いて、図6に示されるように溝底面の第2のマスク層20を除去する（S106）。これにより、第1のマスク層18側に狭まる溝が形成され、第2のマスク層20の側面は、垂直方向から若干傾斜したテーパ形状となる。尚、この際、溝以外の領域のレジスト層22も若干除去される。

【0049】

次に、反応性イオンエッチング装置30を用いてCF₄ガス又はSF₆ガス（ハロゲン系の反応ガス）を用いた反応性イオンエッチングにより、図7に示されるように溝底面の第1のマスク層18を除去する（S108）。

【0050】

具体的には、試料10をESCステージ電極34に載置・固定し、バイアス電圧を印加する。更に、電磁コイル40が磁界を発し、アンテナ42がヘリコン波を発するとヘリコン波は磁界に沿って伝播し、石英製ベル・ジャー36の内部に高密度のプラズマが発生する。給気孔36AからCF₄ガス又はSF₆ガスを供給するとラジカルが拡散チャンバー32内に拡散して第1のマスク層18の表面に付着し、反応する。又、イオンがバイアス電圧により誘導されて試料10に衝突し、第1のマスク層18の表面を除去する。この際、第1のマスク層18のエ

ッチングの進行を過度に制限しない範囲で、バイアス電源38のバイアスパワーを低めに調節しておく。第1のマスク層18は、材料がハロゲン系反応ガスと反応しやすいケイ素を含んでいるので、バイアスパワーをそれだけ低めに調節することができる。

【0051】

これにより、磁性薄膜層16側に狭まる溝が形成され、第1のマスク層18には、垂直方向から若干傾斜したテーパ形状の側面が形成されるが、バイアスパワーを低めに調節しているので、第1のマスク層18の側面のテーパ角は小さく制限される。尚、ここで、溝以外の領域のレジスト層22は完全に除去される。又、溝以外の領域の第2のマスク層20も一部除去されるが若干量が残存する。

【0052】

次に、反応性イオンエッチング装置30又は同様の構造の他の反応性イオンエッチング装置を用いて図8に示されるように溝底面の磁性薄膜層16を除去する(S110)。

【0053】

反応性イオンエッチング装置30を用いる場合を例として具体的に説明すると、上記の第1のマスク層18の反応性イオンエッチングにおけるCF₄ガス又はSF₆ガスに代えて給気孔36AからCOガス及びNH₃ガスを供給するとラジカルが拡散チャンバー32内に拡散して磁性薄膜層16の表面をカーボニル化する。又、イオンがバイアス電圧により誘導されて、カーボニル化された磁性薄膜層16の表面を除去する。

【0054】

これにより、基板12側に狭まる溝が形成され、磁性薄膜層16には、垂直方向から若干傾斜したテーパ形状の側面が形成される。

【0055】

ここで、第1のマスク層18は、材料がケイ素と、タンタルと、を混合したものであり、且つ、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率が(10%以上、且つ、30%以下の)約20%であり、後述するようにCOガス及びNH₃ガスを反応ガスとする反応性イオンエ

ッチングに対するエッチングレートが低い（耐エッチング性が高い）ので、それだけ第1のマスク層18は薄く形成されている。従って、垂直方向から若干傾斜して接近するガスに対し、第1のマスク層18の陰となる部分は小さく、磁性薄膜層16の側面のテーパ角はそれだけ小さく制限される。即ち、パターンが微細であっても、磁性薄膜層16は精密に加工され、磁性薄膜層16が多数の記録要素16Aに分割される。

【0056】

尚、この反応性イオンエッチングにより、溝以外の領域の第2のマスク層20が完全に除去される。又、溝以外の領域の第1のマスク層18も一部が除去されるが一定量が記録要素の上面に残存する。

【0057】

次に、CF₄ガス又はSF₆ガスを用いた反応性イオンエッチングにより、図8に示されるように記録要素16Aの上面に残存する第1のマスク層18を完全に除去する（S112）。尚、CF₄ガス又はSF₆ガスを用いた反応性アッシング装置（図示省略）で記録要素の上面に残存する第1のマスク層18を除去してもよい。

【0058】

これにより、試料10の加工が完了する。

【0059】

以上のように、磁性薄膜層16を被覆する第1のマスク層18の材料として、COガス及びNH₃ガスからなる反応ガスを用いた反応性イオンエッチングに対するエッチングレートが低いケイ素及びタンタルで構成された材料を用いることで、第1のマスク層18の厚さを薄くすることができ、側面のテーパ角が小さい記録要素16Aを形成することができる。

【0060】

又、ケイ素及びタンタルで構成された材料を用いることで、ハロゲン系の反応ガスを用いた反応性イオンエッチングの設定条件を調節し、第1のマスク層18自体の側面のテーパ角を低減でき、これによりパターンの転写精度を高めることができる。

【0061】

更に、記録要素16Aの側面のテーパ角、第1のマスク層18の側面のテーパ角、を低減することができるので、溝のピッチが小さい微細なパターンを磁性薄膜層16に転写することができる。

【0062】

尚、本実施形態において、磁性薄膜層16を加工するための反応性イオンエッチングの反応ガスとしてNH₃ガスが添加されたCOガスを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、COの分解を抑制する作用を有するアミン類ガス等の他の含窒素化合物ガスが添加されたCOガスを反応ガスを用いて磁性薄膜層16を加工してもよい。

【0063】

又、本実施形態において、第1のマスク層18を加工するための反応性イオンエッチングの反応ガスとしてCF₄ガス又はSF₆ガスを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、他のハロゲン系の反応ガスを用いて第1のマスク層18を加工してもよい。

【0064】

又、本実施形態において、磁性薄膜層16、第1のマスク層18を加工するための反応性イオンエッチング装置30はヘリコン波プラズマ方式であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、平行平板方式、マグネットロン方式、2周波励磁方式、ECR (Electron Cyclotron Resonance) 方式、ICP (Inductively Coupled Plasma) 方式等、他の方式の反応性イオンエッチング装置を用いてもよい。

【0065】

又、本実施形態において、レジスト層22及び第2のマスク層20を第1のマスク層18上に形成し、電子線露光装置及びイオンビームエッチングを用いて第2のマスク層20を所定のパターンに形成しているが、ハロゲン系の反応ガスに対して耐エッティング性を有する第2のマスク層を第1のマスク層18上に高精度で形成することができれば、第1のマスク層18上のマスク層、レジスト層の材料、加工方法及びこれらの積層数は特に限定されない。例えば、レジスト層22

に微細な間隔で溝を形成する方法として、電子線露光装置に代えて、ナノ・インプリント法を用いてもよい。

【0066】

又、本実施形態において、第1のマスク層18の材料は、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率が約20%であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、ケイ素と、タンタルと、を混合してなるマスク材料であれば、その比率に拘らず、ハロゲン系の反応ガスを用いた反応性イオンエッティングの設定条件を調節することで、加工形状を制御することが可能であり、マスクに形成されるテーパ角を低減することができる。

【0067】

尚、後述するように、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率を50%以下とすれば、CO及びNH₃を反応ガスとする反応性イオンエッティングに対するエッティングレートをタンタル単体よりも低く（耐エッティング性を高く）でき、特にケイ素の原子数の比率を10%以上、且つ、30%以下とすることで、タンタル単体よりもエッティングレートを大幅に低くすることができ、好ましい。

【0068】

又、本実施形態において、第1のマスク層18の材料は、ケイ素と、タンタルと、を混合してなるマスク材料であるが、ケイ素に代えて、例えば二酸化ケイ素、窒化ケイ素等の他のケイ素系の材料を用いてもよい。また、タンタルに代えて、例えば酸化タンタル、窒化タンタル等の他のタンタル系材料を用いてもよい。また、ケイ素とタンタルとを含む化合物を用いてもよい。また、ケイ素系材料の層とタンタル系材料の層との積層体でもよい。尚、積層体の場合、ケイ素系材料の層がタンタル系材料を含んでいてもよく、タンタル系材料の層がケイ素系材料を含んでいてもよい。この場合も、ハロゲン系の反応ガスを用いた反応性イオンエッティングの設定条件を調節することで、マスクの加工形状を制御し、マスクに形成されるテーパ角を低減することが可能である。又、CO及びNH₃を反応ガスとする反応性イオンエッティングに対するエッティングレートをタンタル単体よりも低くすることもできる。

【0069】

又、本実施形態において、試料10はガラス基板12に磁性薄膜層16を直接形成した構成の試験用の試料であるが、ハードディスク等の磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、磁気ヘッド等、磁性材を有して構成される種々の記録媒体、装置の加工に本発明を適用可能であることは言うまでもない。

【0070】

又、本実施形態において、磁性薄膜層16の材質はC o C r合金であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、鉄属元素(C o、F e(鉄)、N i)を含む他の合金、これらの積層体等の他の材質の磁性材の加工のためのマスク材料としても、ケイ素と、タンタルと、を混合してなるマスク材料は好適である。

【0071】

又、本実施形態において、ケイ素と、タンタルと、を混合してなるマスク材料を磁性材の加工のために用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、CO及びNH₃を反応ガスとする反応性イオンエッティングで加工可能な材料であれば、例えばPt等の非磁性材の加工のためのマスク材料としても、ケイ素と、タンタルと、を混合してなるマスク材料は好適である。

【0072】

(実施例1)

上記実施形態のとおり、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率を約20%とした。即ち、タンタルの原子数と、ケイ素の原子数との組成比率を約4:1とした。

【0073】

又、磁性薄膜層16の厚さを約25nm、第1のマスク層18の厚さを約20nm、第2のマスク層20の厚さを約15nm、レジスト層22の厚さを約130nmとし、試料10の出発体を2個作製した。

【0074】

レジスト層22に、ピッチが約120nm、ラインとスペースとの比率が約1:1のパターン(即ちライン幅、スペース幅がいずれも約60nmのパターン)

を露光・現像したところ、側面が垂直な溝が形成された。

【0075】

第2のマスク層20には、側面がテーパ形状の溝が形成され、溝底面のスペース幅は約55nm（ライン幅は約65nm）であった。

【0076】

第1のマスク層18にも側面がテーパ形状の溝が形成された。第1のマスク層18の加工において、ソースパワーは1000Wで一定に保持する一方、バイアスパワーは2つの試料について異なる値とし、それぞれ150W、75Wに調節したところ、バイアスパワーが150Wの場合、溝底面のスペース幅は約23nmであった。一方、バイアスパワーが75Wの場合、溝底面のスペース幅は約38nmであった。尚、反応性イオンエッティング装置のステージ電極は直径6インチのものを用いた。

【0077】

磁性薄膜層16にも側面がテーパ形状の溝が形成された。尚、磁性薄膜層16の加工においては、いずれの試料についてもソースパワーを1000W、バイアスパワーを250Wで一定に保持した。第1のマスク層18の底面のスペース幅が23nmの場合、磁性薄膜層16の底面のスペース幅は約15nmであった。一方、第1のマスク層18の底面のスペース幅が38nmの場合、磁性薄膜層16の底面のスペース幅は約29nmであった。

【0078】

（実施例2）

上記実施例1に対し、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率を約80%とした。即ち、タンタルの原子数と、ケイ素の原子数との組成比率を約1:4とした。その他の条件は、上記実施例1と同様とし、試料10の出発体を2個作製した。レジスト層22、第2のマスク層20を加工したところ、第2のマスク層20には、側面がテーパ形状の溝が形成され、実施例1と同様に底面のスペース幅は約55nm（ライン幅は約65nm）であった。

【0079】

又、実施例1と同様に、第1のマスク層18の加工において、ソースパワーは1000Wで一定に保持する一方、バイアスパワーは2つの試料について異なる値とし、それぞれ150W、75Wに調節したところ、バイアスパワーが150Wの場合、溝底面のスペース幅は約15nmであった。一方、バイアスパワーが75Wの場合、溝底面のスペース幅は約45nmであった。

【0080】

又、磁性薄膜層16にも側面がテーパ形状の溝が形成され、第1のマスク層18の底面のスペース幅が15nmの場合、磁性薄膜層16の底面のスペース幅は約7nmであった。一方、第1のマスク層18の底面のスペース幅が45nmの場合、磁性薄膜層16の底面のスペース幅は約36nmであった。

【0081】

(比較例)

上記実施例1に対し、第1のマスク層18の材料をケイ素を含まない、ほぼ純粋なタンタルとした。その他の条件は、上記実施例1と同様とし、試料10の出発体を2個作製した。レジスト層22、第2のマスク層20を加工したところ、第2のマスク層20には、側面がテーパ形状の溝が形成され、底面のスペース幅は約55nm（ライン幅は約65nm）であった。

【0082】

実施例1と同様に、第1のマスク層18の加工において、ソースパワーは1000Wで一定に保持する一方、バイアスパワーは2つの試料について異なる値とし、それぞれ150W、75Wに調節したところ、バイアスパワーが150Wの場合、底面のスペース幅は約25nmであった。一方、バイアスパワーが75Wの場合も、底面のスペース幅は約25nmであった。

【0083】

以上、実施例1、実施例2及び比較例の結果を表1に対比して示す。

【0084】

【表1】

	実施例1		実施例2		比較例	
第2のマスク層の材質	Ni		Ni		Ni	
第1のマスク層の材質	Ta:Si =4:1		Ta:Si =1:4		Ta	
レジスト層底面のスペース幅(nm)	60		60		60	
第2のマスク層底面のスペース幅(nm)	55		55		55	
第1のマスク層の加工におけるバイアスパワー(W)	150	75	150	75	150	75
第1のマスク層底面のスペース幅(nm)	23	38	15	45	25	25
磁性薄膜層底面のスペース幅(nm)	15	29	7	36	—	—

【0085】

実施例1、実施例2では、比較例に対して、磁性薄膜層16の加工形状を、側面のテーパ角が小さいものとすることができた。また、実施例1、実施例2では、バイアスパワーを調節することで、側面のテーパ角が小さくなることが確認された。一方、比較例ではバイアスパワーを調節しても、スペース幅は一定で変化しないことが確認された。

【0086】

(実施例3)

ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率が異なる複数種類のマスク材料で第1のマスク層18を形成し、COガス及びNH₃ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティングにおける、第1のマスク層18の選択比を測定したところ図9に示されるような結果が得られた。ここで、選択比は、磁性薄膜層16のエッティング速度を第1のマスク層18のエッティング速度で除した値である。

【0087】

図9に示されるように、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率が0%よりも大きく、且つ、50%以下であれば、選択比は、純粋なタンタルを材料とするマスクの選択比である33よりも大きくなり、マスク材料として好ましい比率であることが確認された。

【0088】

又、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率が5%以上、且つ、40%以下であれば、選択比が45以上となり更に好ましく、特に、ケイ素の原子数の比率が10%以上、且つ、30%以下であれば、50以上の選択比が得られ、一層好ましい比率であることが確認された。尚、ケイ素の原子数の比率が約20%で選択比は約66.7で最大となり、特に好ましい。

【0089】

尚、ケイ素の原子数と、タンタルの原子数と、を合計した原子数に対するケイ素の原子数の比率が80%を超えると、記録要素16Åの側面上端近傍が過度に除去される傾向があり、パターン、マスクの膜厚、反応性イオンエッチングの設定条件等を調整しても、記録要素16Åが丸みを帯びた形状に加工され、所望の加工が困難となる場合があるため、ケイ素の原子数の比率は80%以下が好ましい。

【0090】**【発明の効果】**

以上説明したように、本発明によれば、含窒素化合物ガスが添加された一酸化炭素ガスを反応ガスとする反応性イオンエッチングを用いて被加工体のエッチング対象領域を精密に加工することが可能となるという優れた効果がもたらされる。

【図面の簡単な説明】**【図1】**

本発明の実施形態に係る試料の出発体の構成を模式的に示す側断面図

【図2】

同出発体を加工して得られる試料の完成体の構造を模式的に示す側断面図

【図3】

同試料の加工に用いられる反応性イオンエッティング装置の構造を模式的に示す一部ブロック図を含む側面図

【図4】

同試料の加工工程を示すフローチャート

【図5】

レジスト層がパターンで分割された試料の形状を示す側断面図

【図6】

溝底面の第2のマスク層が除去された試料の形状を模式的に示す側断面図

【図7】

溝底面の第1のマスク層が除去された試料の形状を模式的に示す側断面図

【図8】

磁性薄膜層が分割された試料の形状を模式的に示す側断面図

【図9】

第1のマスク層の材料のケイ素の比率とエッティングの選択比との関係を示すグラフ

【図10】

理想的な凹部形状及び従来のドライエッティングによる実際の凹部形状を模式的に示す側断面図

【符号の説明】

1 0 … 試料

1 2 … ガラス基板

1 6 … 磁性薄膜層

1 8 … 第1のマスク層

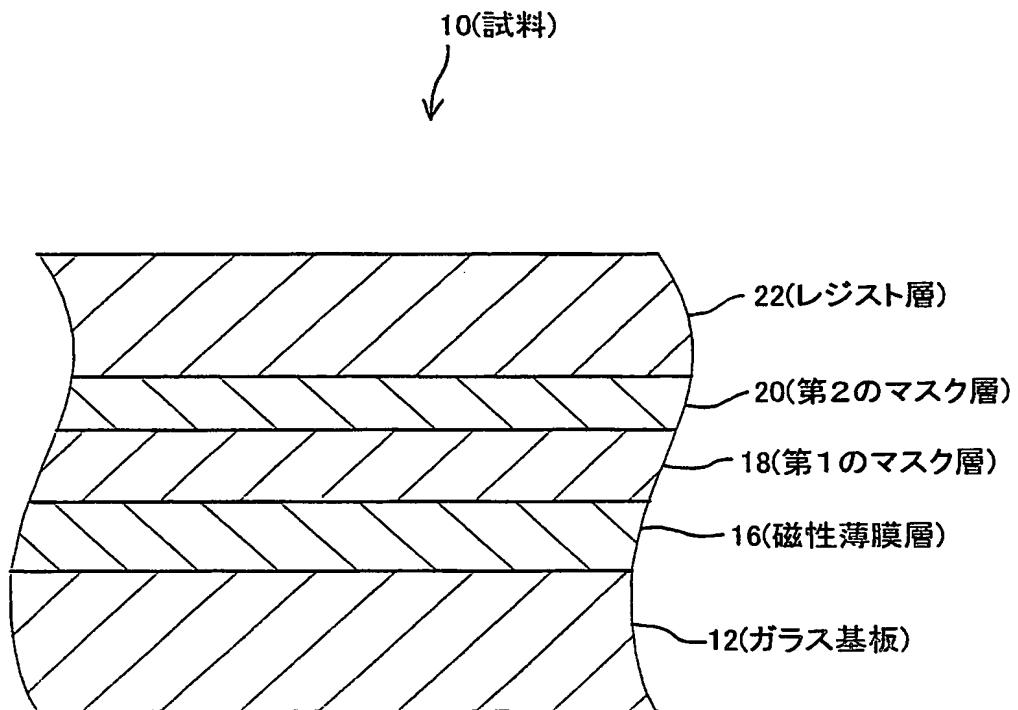
2 0 … 第2のマスク層

2 2 … レジスト層

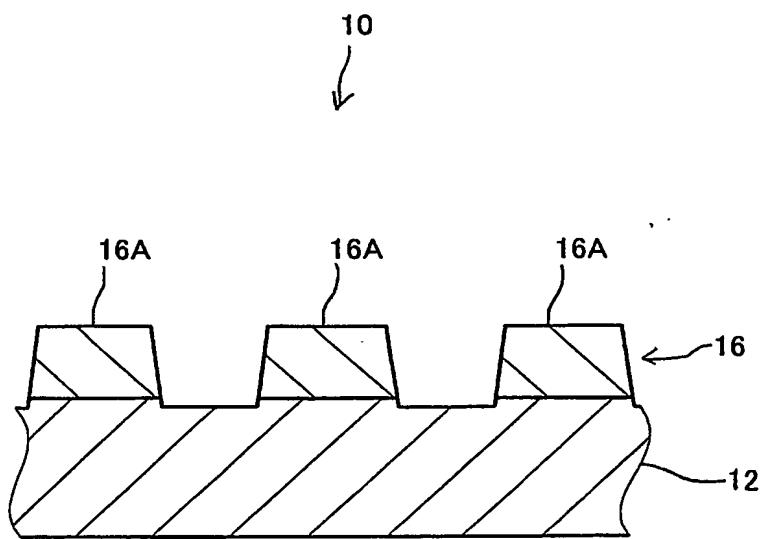
3 0 … 反応性イオンエッティング装置

【書類名】 図面

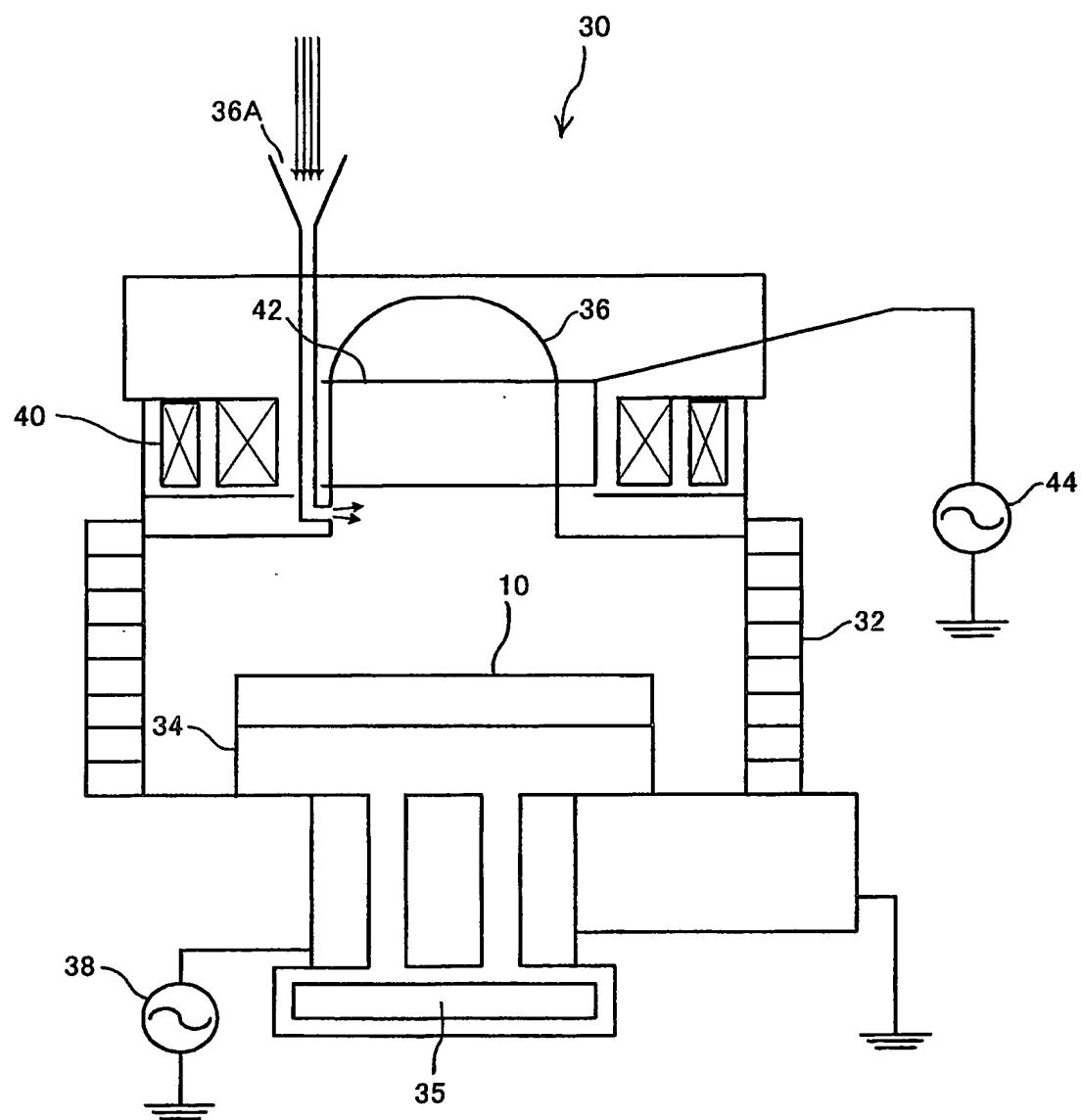
【図 1】



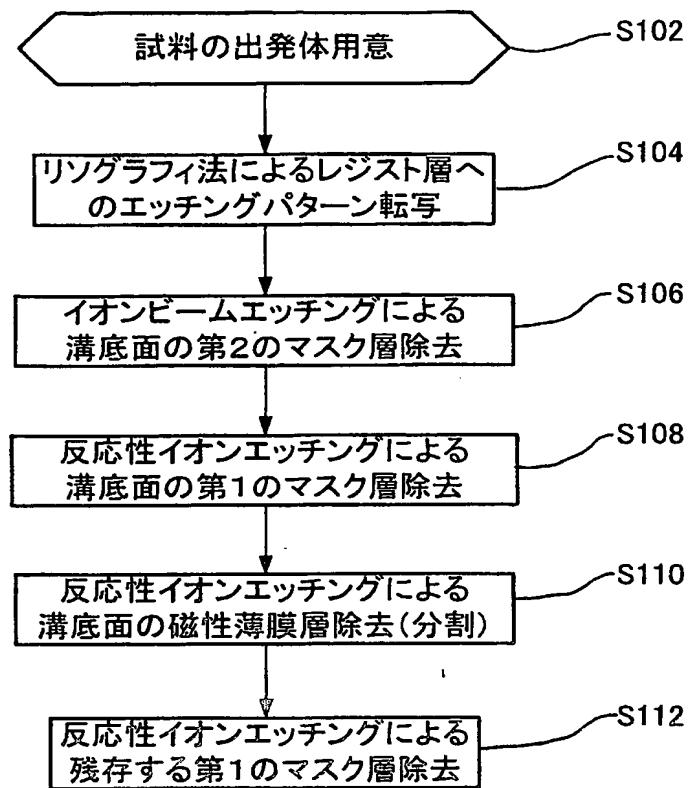
【図 2】



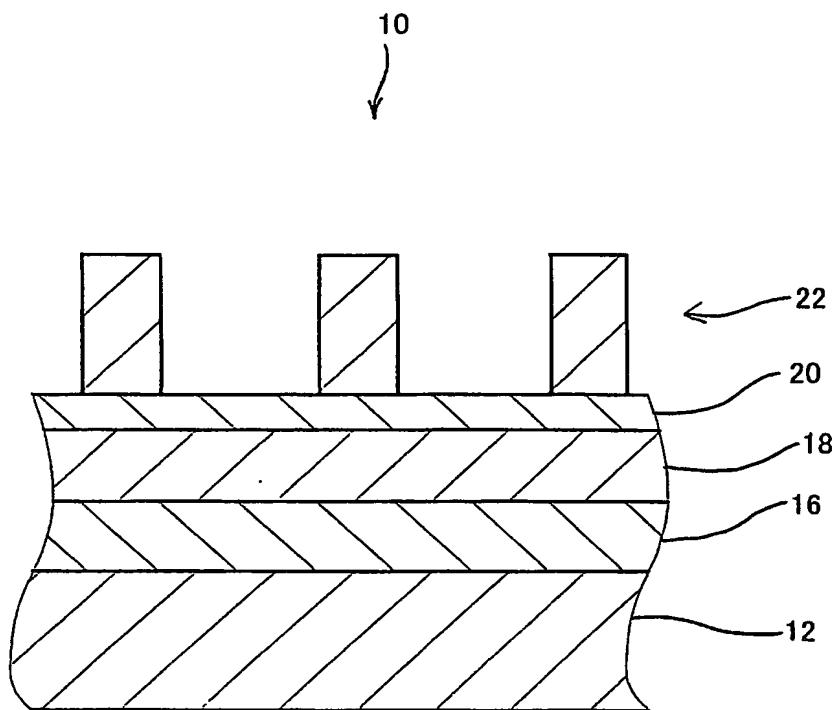
【図3】



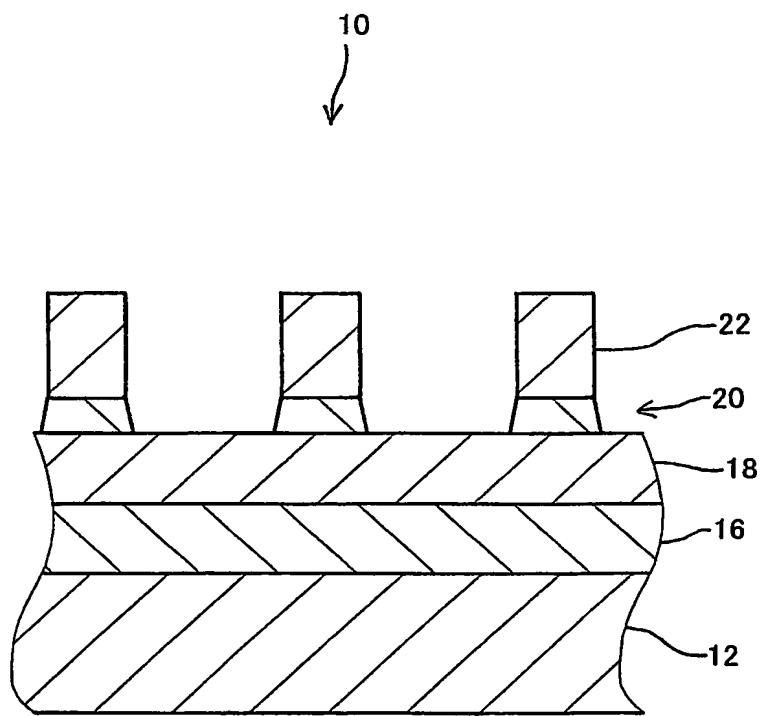
【図4】



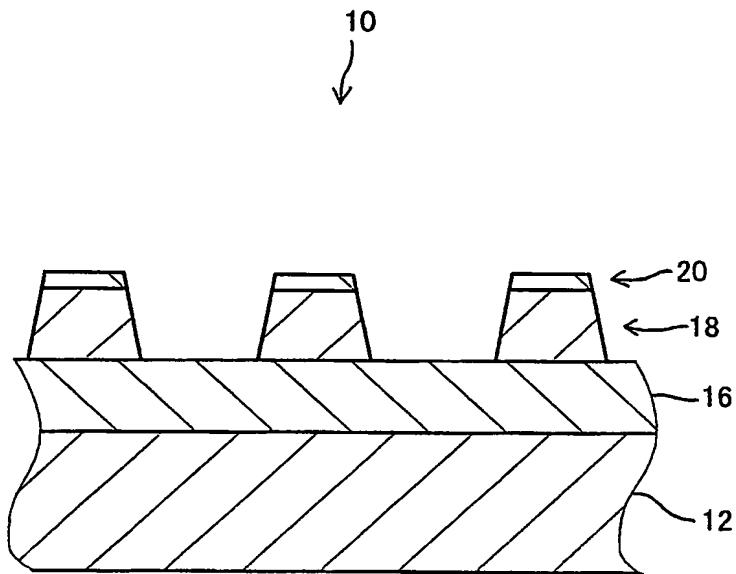
【図 5】



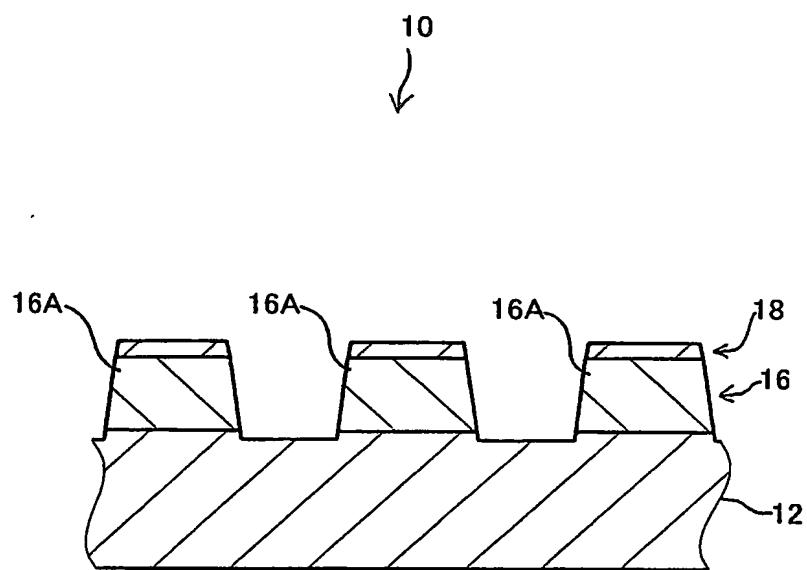
【図 6】



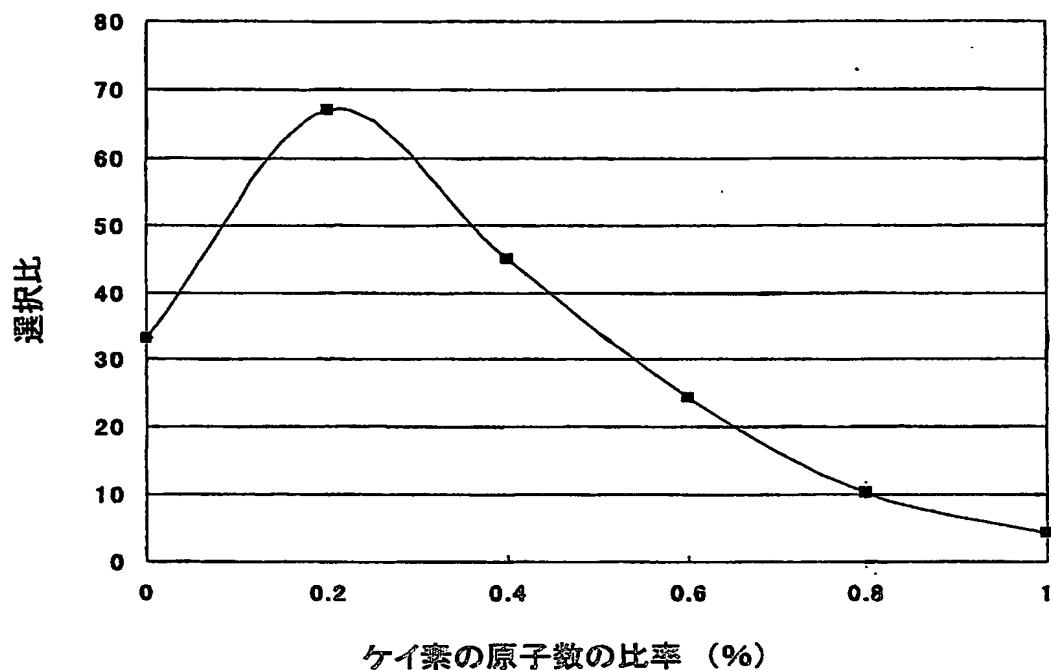
【図7】



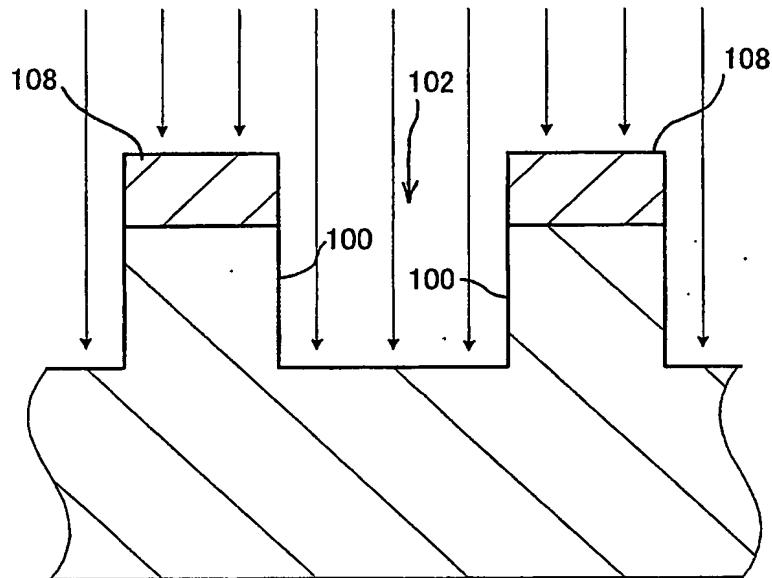
【図8】



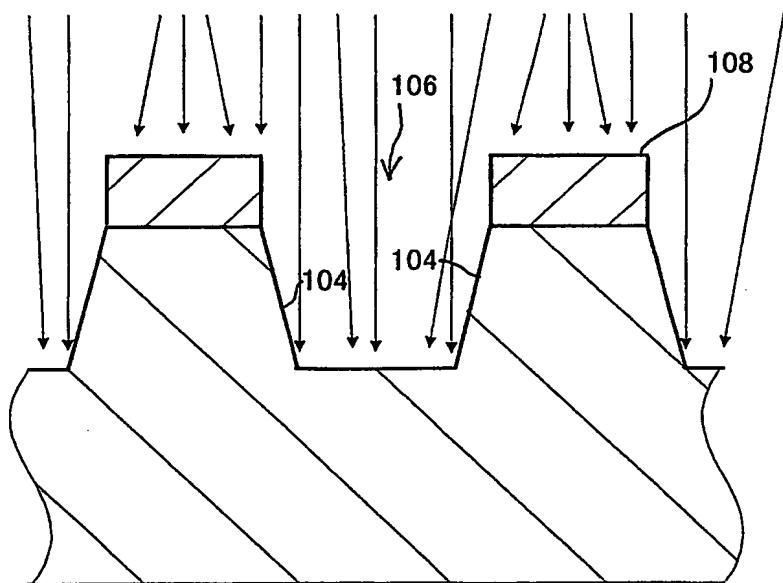
【図9】



【図10】



(A)



(B)

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 含窒素化合物ガスが添加された一酸化炭素ガスを反応ガスとする反応性イオンエッティングを用いて被加工体のエッティング対象領域を精密に加工することができるドライエッティング方法等を提供する。

【解決手段】 磁性薄膜層16を被覆する第1のマスク層18の材料を、ケイ素と、タンタルと、を含む材料とした。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-188468
受付番号	50301093185
書類名	特許願
担当官	植田 晴穂 6992
作成日	平成15年 7月 3日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000003067
【住所又は居所】	東京都中央区日本橋1丁目13番1号
【氏名又は名称】	T D K株式会社

【代理人】

【識別番号】	100076129
【住所又は居所】	東京都渋谷区代々木2丁目10番12号 南新宿 ビル 松山・高矢・牧野特許事務所
【氏名又は名称】	松山 圭佑

【選任した代理人】

【識別番号】	100080458
【住所又は居所】	東京都渋谷区代々木2丁目10番12号 南新宿 ビル 松山・高矢・牧野特許事務所
【氏名又は名称】	高矢 諭

【選任した代理人】

【識別番号】	100089015
【住所又は居所】	東京都渋谷区代々木二丁目10番12号 南新宿 ビル 松山・高矢・牧野特許事務所
【氏名又は名称】	牧野 剛博

特願 2003-188468

出願人履歴情報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日 2003年 6月27日

[変更理由] 名称変更

住所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏名 TDK株式会社